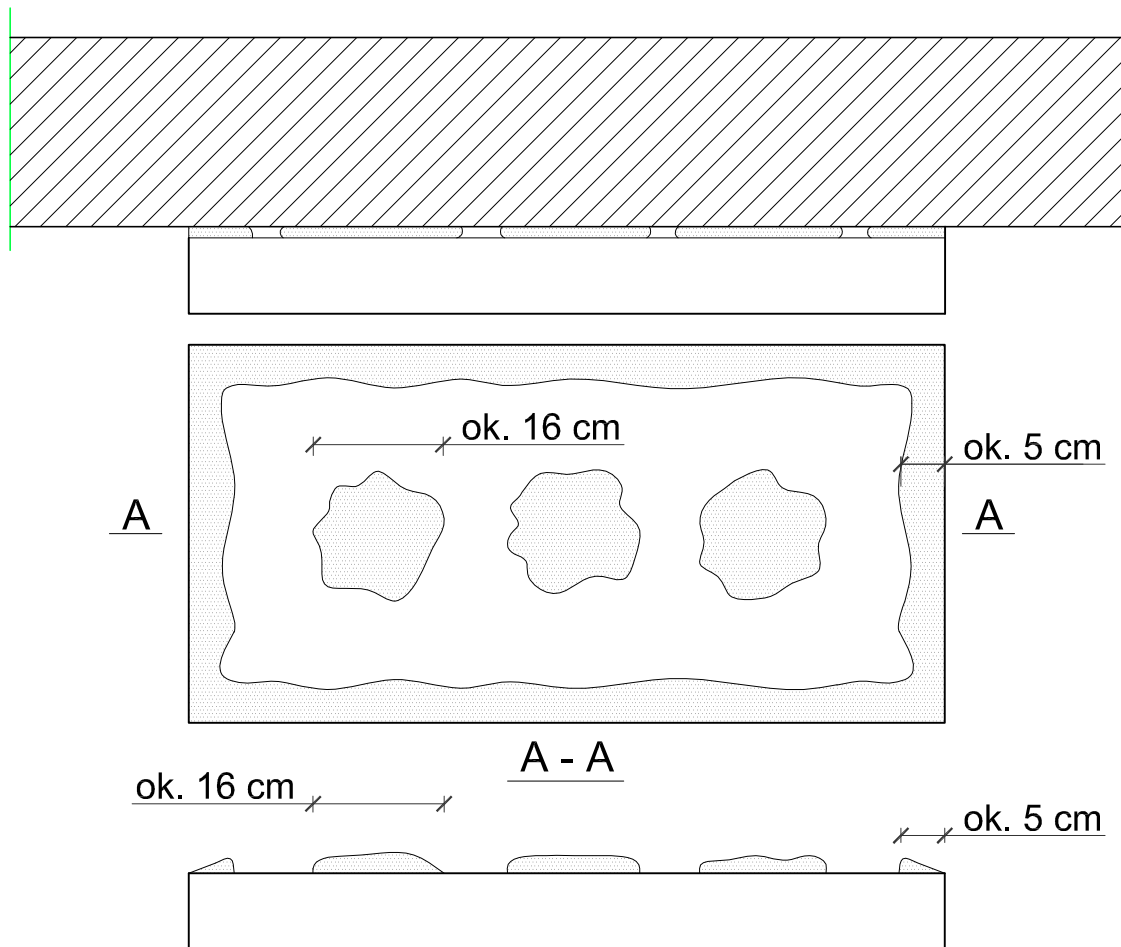


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

PROJEKT WYKONAWCZY	
ZAPEWNIENIE PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	
W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZECZ BUDOWĘ NOWOCZESNEGO	
PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH" BUDYNEK PRZEDSZKOLA	
WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ TJ.:	
PLACEM ZABAW, PARKINGIEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH	
ROZBIÓRKA BUD. DAWNEJ POCZTY I ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI	
	SKALA 1:10
DETAL OCIEPLENIA – detal klejenia płyt	
DANE Gmina Radziejowice	
INWESTORA: ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice	
ADRES Radziejowice ul. Kubickiego	
BUDOWY: Dz. nr ew. 162/2, 75	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek 356/78	PODPIS:
Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	

